

- [1] D. Koh, J.-H. Yum, S. K. Banerjee, T. W. Hudnall, C. Bielawski, W. A. Lanford, B. L. French, M. French, P. Henry, H. Li, M. Kuhn, S. W. King, *J. Vac. Sci. Technol. B* 32, 03D117 (2014).
- [2] D. W. Johnson, J. H. Yum, T. W. Hudnall, R. M. Mushinski, C. W. Bielawski, J. C. Roberts, W.-E. Wang, S. K. Banerjee and H. R. Harris, *J. of ELECTRONIC MATERIALS*, Vol. 43, No. 1, 2014.
- [3] S. M. Lee, Y. Jang, J. Jung, J. H. Yum, E. S. Larsen, S. Y. Lee, H. Seo, C. W. Bielawski, H.-D. Lee and J. Oh, *ACS Appl. Electron. Mater.* 2019, 1, 617–624.
- [4] S. M. Lee, D. H. Jung, S. Yoon, Y. Jang, J. H. Yum, E. S. Larsen, C. W. Bielawski, J. Oh, *App. Surface Science*, 505 (2020), 144107.
- [5] Y. Jang, S. M. Lee, D. H. Jung, J. H. Yum, E. S. Larsen, C. W. Bielawski, J. Oh, *Solid State Electronics*, 163 (2020) 107661.
- [6] J. H. Yum, T. Akyol, M. Lei, T. Hudnall, G. Bersuker, M. Downer, C. W. Bielawski, J. C. Lee, S. K. Banerjee, *J. Appl. Phys.*, 109, 064101 (2011).
- [7] C. Berthold, J. Maurer, L. Klerner, S. Harder and M. R. Buchner, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2024, 63, e202408422.
- [8] M. R. Buchner and S. I. Ivlev, *Eur. J. Inorg. Chem.* 2023, 26, e202300199.
- [9] M. R. Buchner and M. Müller, *ACS Chem. Health Saf.* 2023, 30, 36–43.
- [10] M. R. Buchner, L. R. Thomas-Hargreaves, L. K. Kreuzer, N. Spang and S. I. Ivlev, *Eur. J. Inorg. Chem.* 2021, 4990–4997.
- [11] M. R. Buchner, *Z. Nat. B*, vol. 75, no. 5, 2020, 405–412.
- [12] M. R. Buchner, M. Müller and S. S. Rudel, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2017, 56, 1130–1134.
- [13] D. Naglav, M. R. Buchner, G. Bendt, F. Kraus and S. Schulz, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2016, 55, 10562–10576.